

図研エルミック株式会社 会社説明会

(東証マザーズ：4770)

2012年11月26日

代表取締役社長 朝倉 尉

2013年 3月期 第2四半期

決算報告

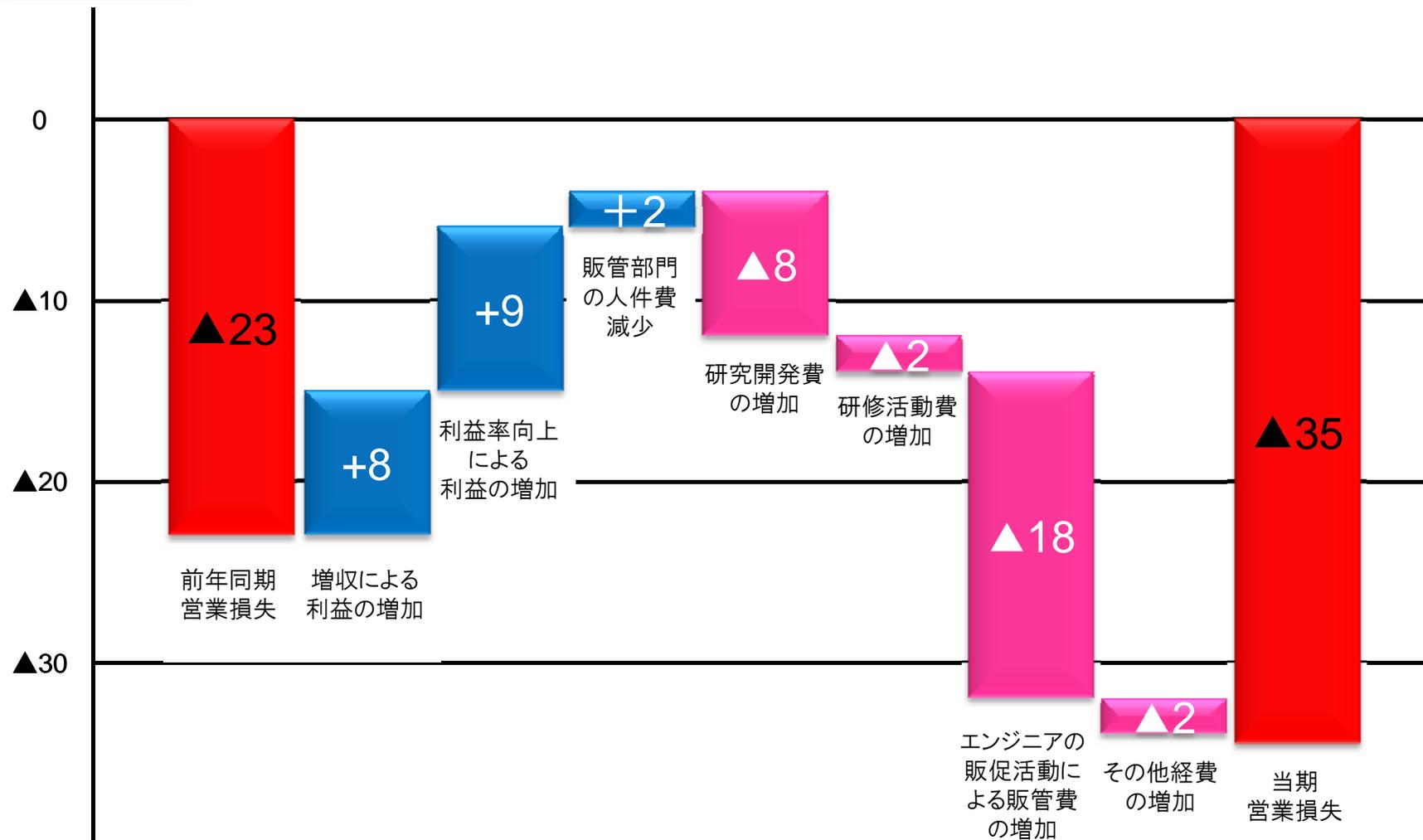
業績結果

36期 単位：百万円、%	第1四半期		第2四半期		上半期	
	実績	前年同期比	実績	前年同期比	実績	前年同期比
売上高	321	126%	366	88%	688	103%
売上原価	214	144%	188	75%	403	101%
売上総利益	107	101%	177	109%	284	106%
販管費	167	116%	152	103%	319	109%
営業損益	▲60	▲21	25	+10	▲35	▲11
経常損益	▲59	▲23	25	+10	▲34	▲13
当期純損益	▲60	▲23	27	+13	▲33	▲10

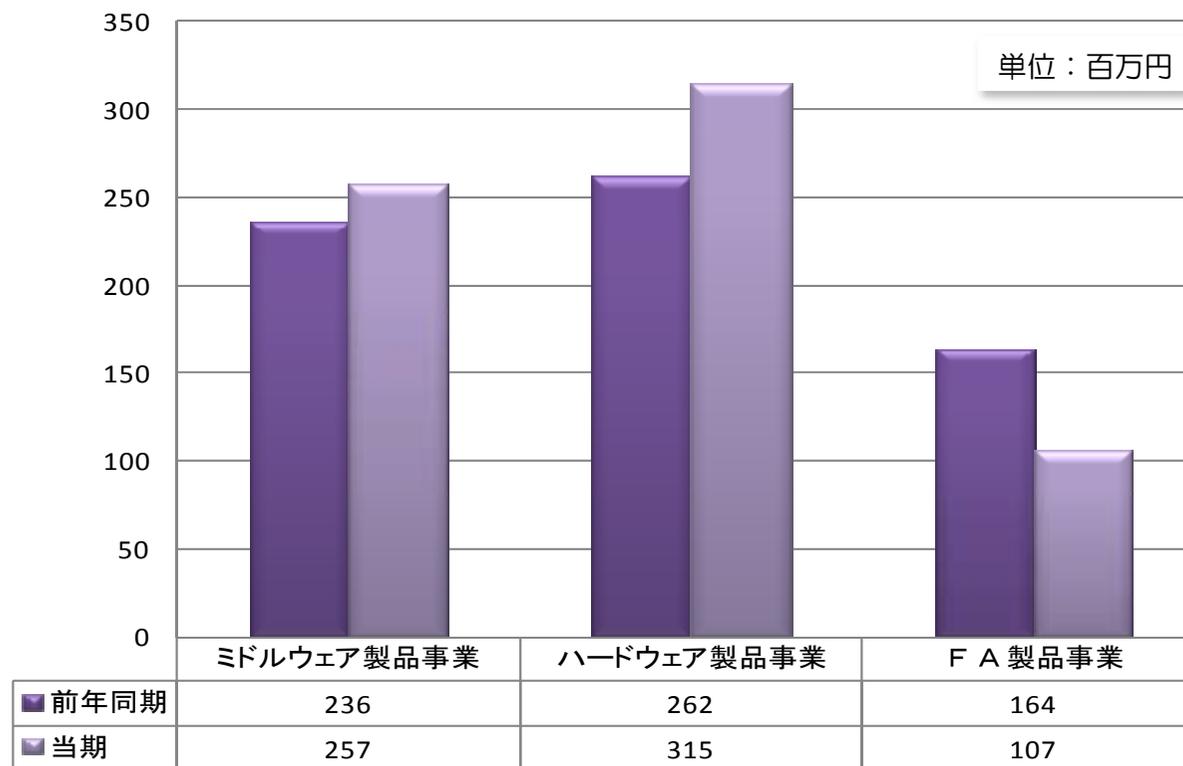
- 第1四半期における赤字ハードウェア開発業務の売上計上に伴う原価の増加。
- ハードウェア製品ならびにミドルウェア製品への研究開発投資による販管費の増加。
- FA製品事業の低迷に伴う、売上高減少ならびに空き工数による販管費の増加。
- ミドルウェア 製品Royalty収入並びにボード製品販売増加に伴う、第2四半期の黒字化。

営業損失 変動要因

単位：百万円



売上高 前年同期比較 (セグメント別)



- **ミドルウェア製品事業**

大型開発案件の遅延による売上高減少が見込まれたものの、IPセキュリティ分野・車載分野向け新製品販売の増加およびTCP/IP分野でのRoyalty収入増加等により、売上増加。前年同期比¥21M増(9%増)。

- **ハードウェア製品事業**

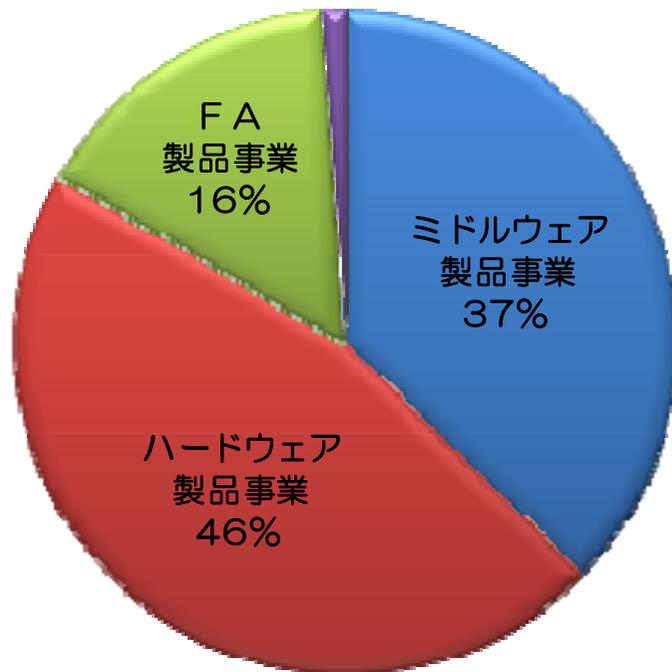
特定顧客向けカスタム製品販売とLSI設計環境販売が好調に推移し、売上高増加。前年同期比¥53M増(20%増)。

- **FA製品事業**

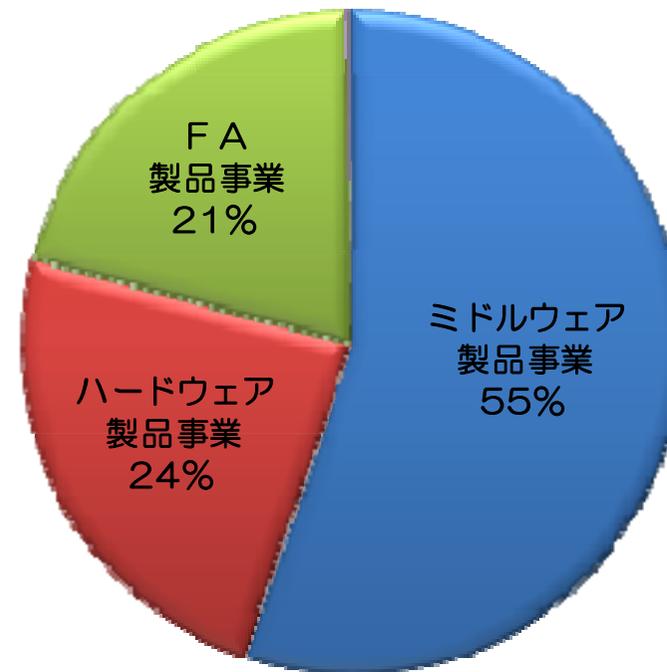
製品販売の低迷や大口顧客の開発中止などの影響を受け、売上高減少。前年同期比¥57M減(35%減)。

セグメント別 構成比率 (上半期)

売上

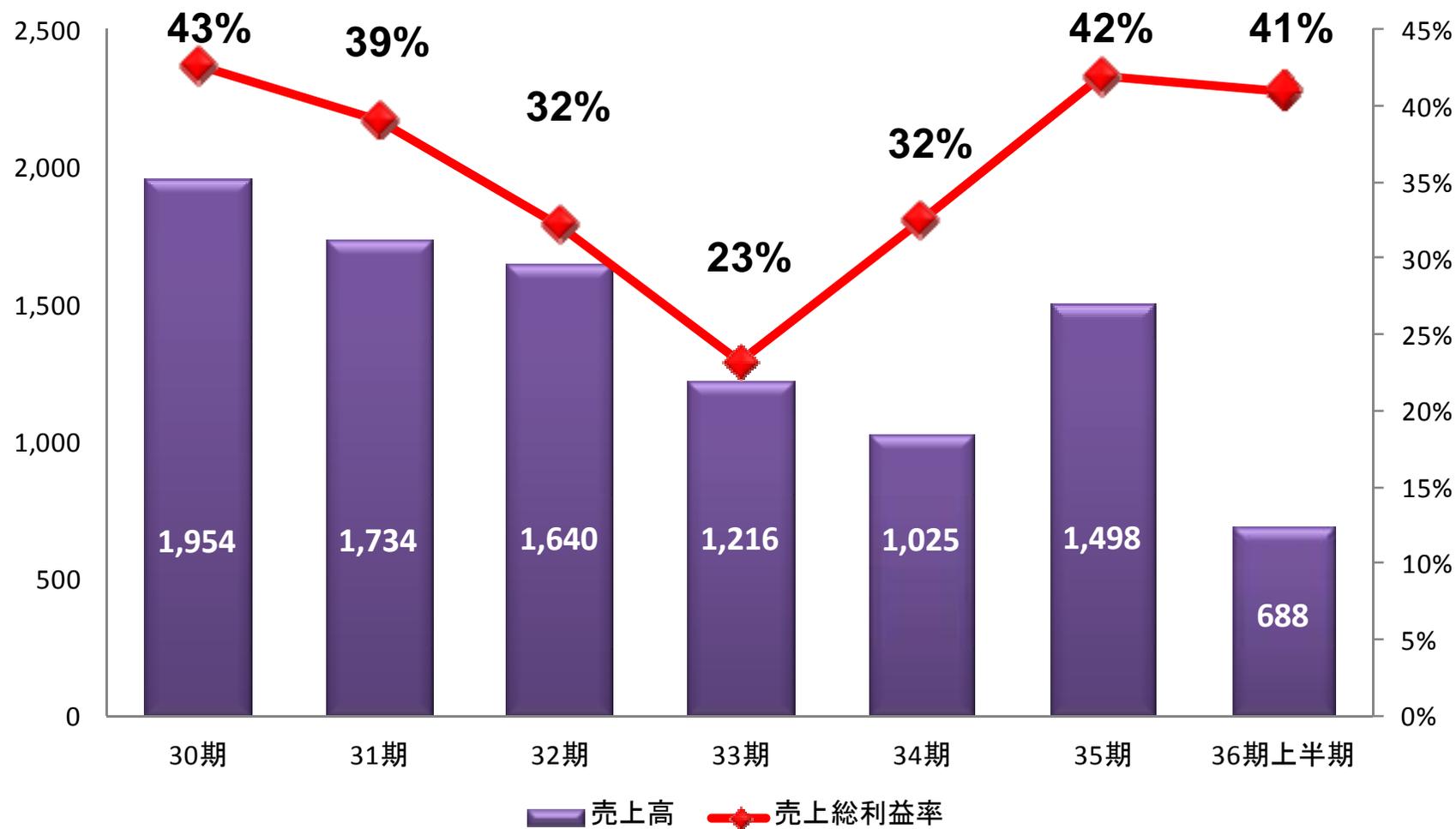


粗利



業績推移

単位：百万円, %



体制の見直しについて

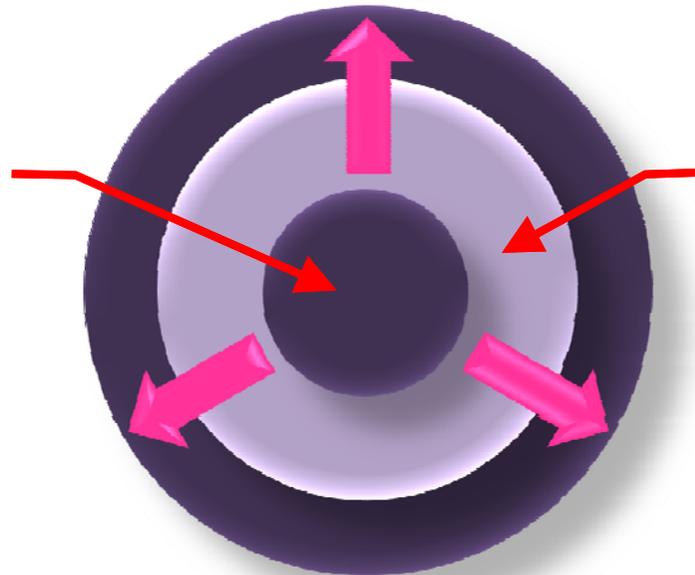
組込コア技術のリーディング・カンパニー
～ Embedded Value-sourcing ～

**付加価値が高く ユニークな
コア技術を持ち、
ロイヤルティ/量産供給ビジネスを確立し、
お客様の事業パートナーとなる。**

経営方針

**製品販売を主体とした
収益力の高いビジネスモデルによる、
強固な経営基盤の確立**

高付加価値で
ユニークなコア技術



コア技術を広く展開
するための技術連携

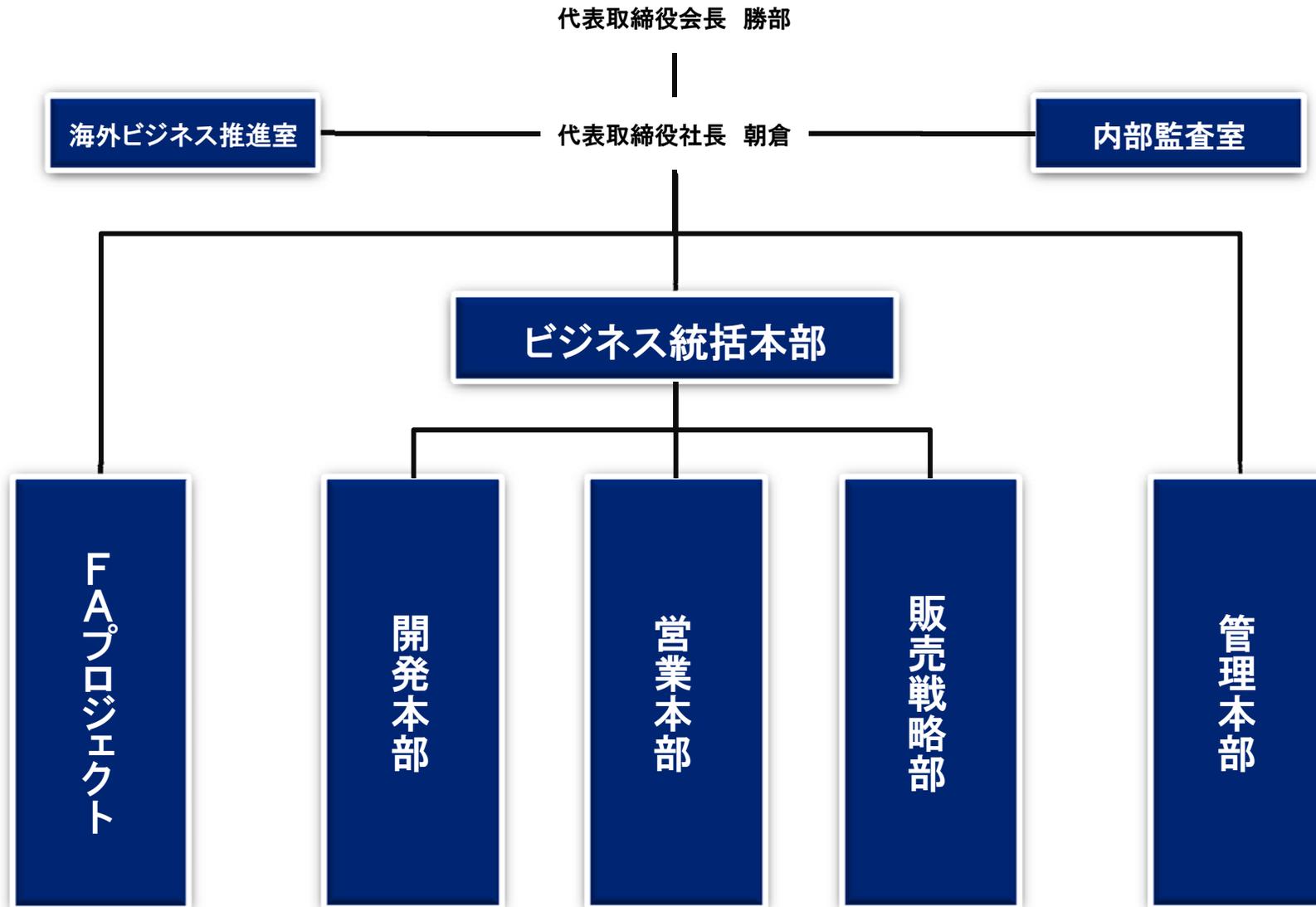
コア技術を増強し、技術を連携させ、同心円的にビジネスを拡大。

体制変更の目的

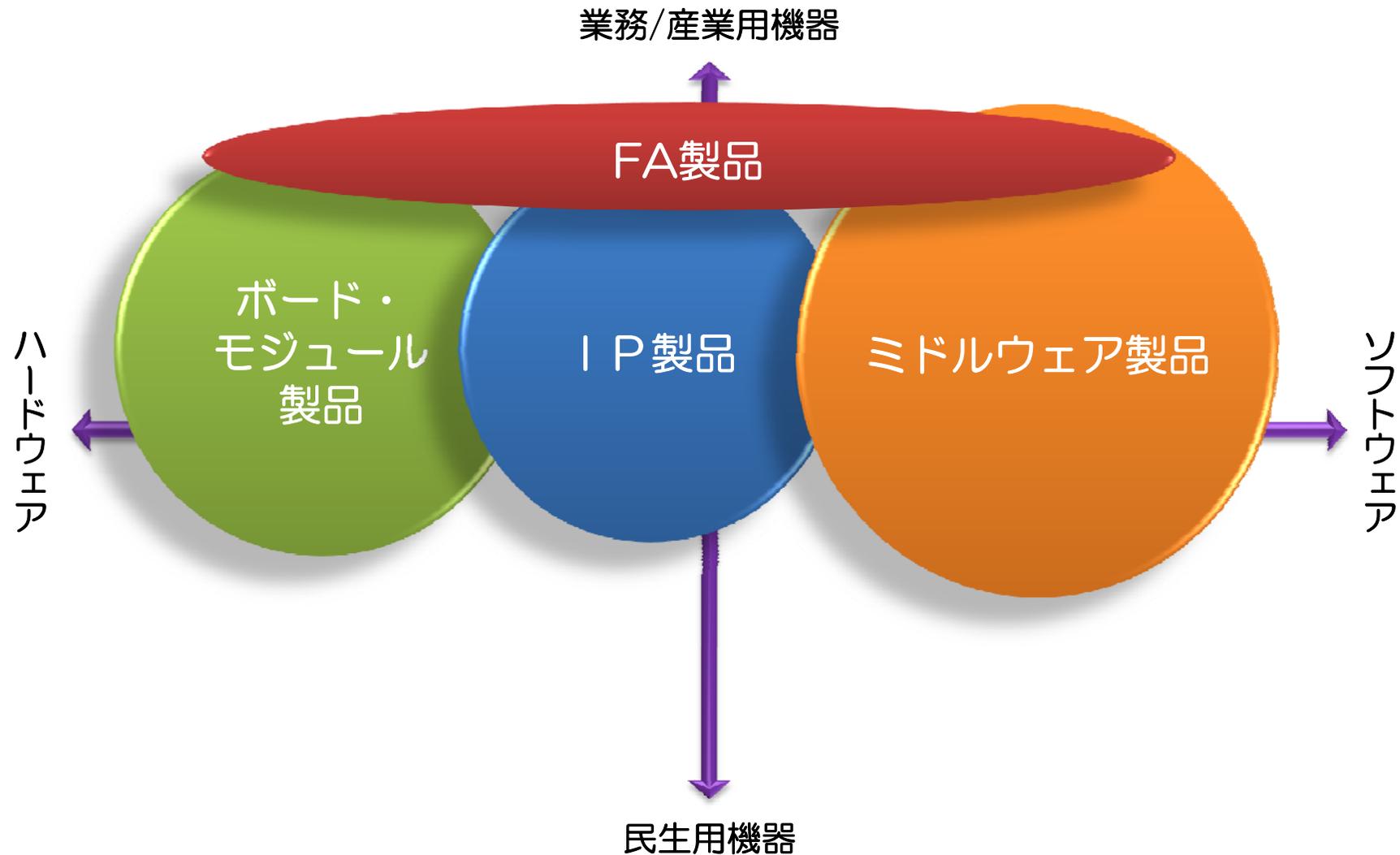
「製品販売を主体とした収益力の高いビジネスモデル」の構築をより加速させるため、また技術連携をより推進するために事業部制を廃止し、事業セグメントを明確にした組織へ再編。

- **利益率の高いミドルウェア製品事業へより多くの開発リソースを投入する。**
- **利益率の低い受託型のハードウェアビジネスを終息させ、利益率の高いLSI用IPとモジュール製品開発に集中し、新市場を拡大するハードウェア製品事業へ再構築する。**
- **FA製品事業の確実な立上げに集中し、事業拡大のための新製品開発を加速する。**

新体制



組込システム市場での当社取組み



事業セグメント別 方針

ミドルウェア製品事業

- ミドルウェア製品を開発し、ライセンス及びロイヤルティビジネスを展開。
 - 既存製品(KASAGO / ONVIF / Mirror Link)の拡販に注力。
 - EMS, スマートフォンアクセサリなどの新市場向け製品開発を推進。

ハードウェア製品事業

- MWと連携したLSI用 IPを開発し、ライセンス及びロイヤルティビジネスを展開。
 - MWと連携したモジュール製品を開発し、量産供給ビジネスを展開。
 - FPGA設計者などの新しいターゲット市場の開拓を推進。

FA製品事業

- FA分野に特化したSW/HW製品を開発し、ライセンス及び量産供給ビジネスを展開。
 - 既存製品(iNHERITOR II / II A)の販売店による拡販を推進。
 - Ethernet方式のFAネットワークなどの新市場向け製品開発を推進。

2013年 3月期 業績見通し

(重点活動方針)

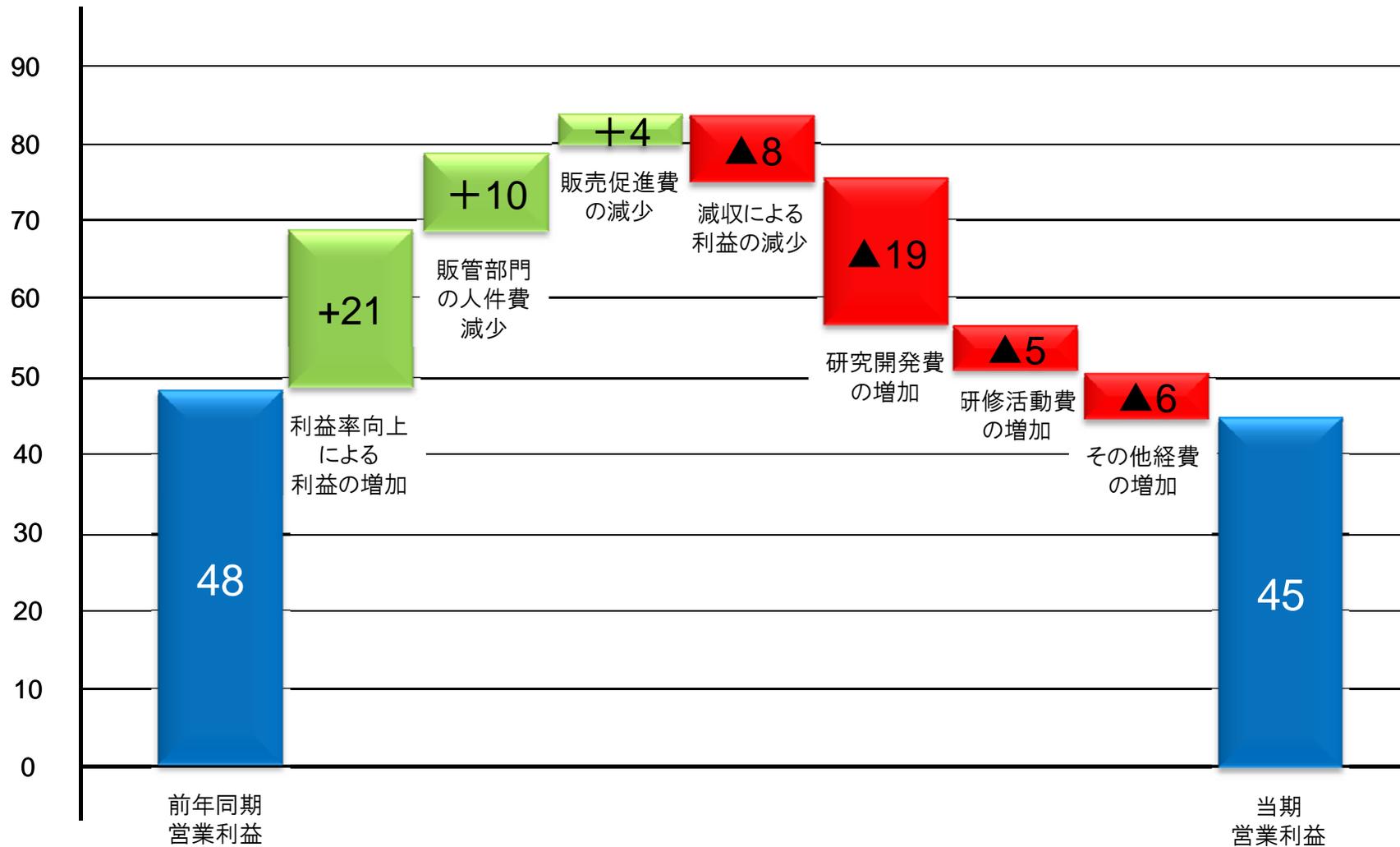
2013年 3月期 業績見通し

36期 単位：百万円、%	第2四半期 累計		通期	
	実績	前年 同期比	見込	前年 同期比
売上高	688	103%	1,500	100%
売上原価	403	101%	854	97%
売上総利益	284	106%	646	104%
営業利益	▲35	▲11	10	41% (▲14)
経常利益	▲34	▲13	10	29% (▲24)
当期純利益	▲33	▲10	0	+52

- 上半期での売上高の減少ならびに損失増加による通期業績予想の修正。
- 一部の大型開発案件の納期遅延に伴う売上原価の増加および利益の減少。
- FA製品事業の立上げ遅延に伴い、今年度業績への貢献見通しの修正。

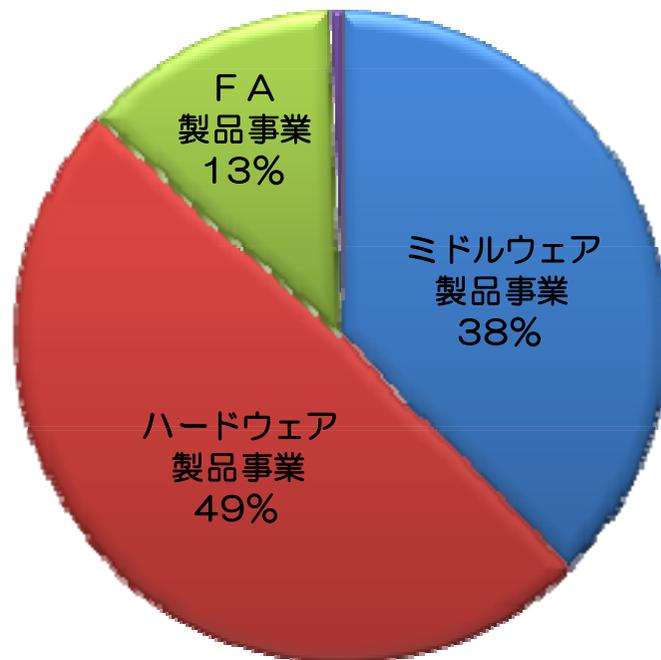
下半期 営業利益 変動要因

単位：百万円

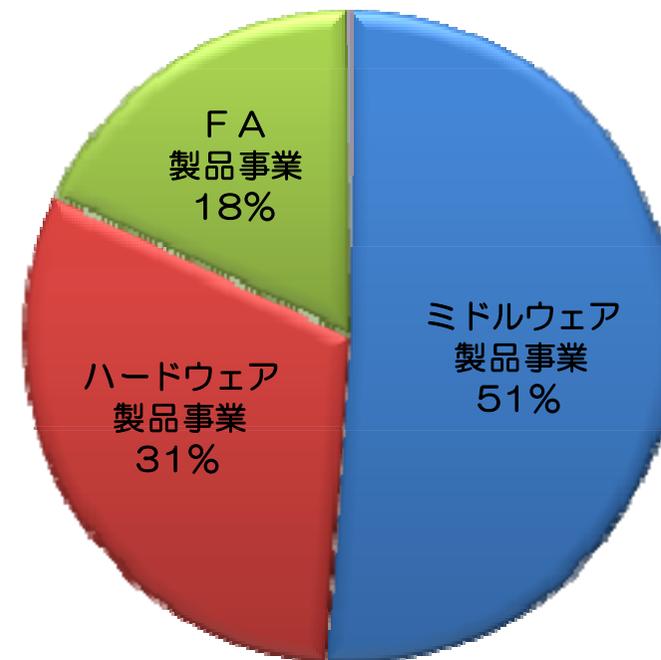


セグメント別 構成比率見通し (通期)

売上



粗利



ミドルウェア製品事業

当社のネットワーク技術を応用した2製品に注力し、事業を展開。

1. IPセキュリティ分野

- IPセキュリティ機器向け標準IF規格であるONVIF準拠のライブラリ群の拡販。
- 新規格であるProfile S対応製品のリリースによる顧客層の拡大。
- パートナーと連携し、海外顧客へ展開。

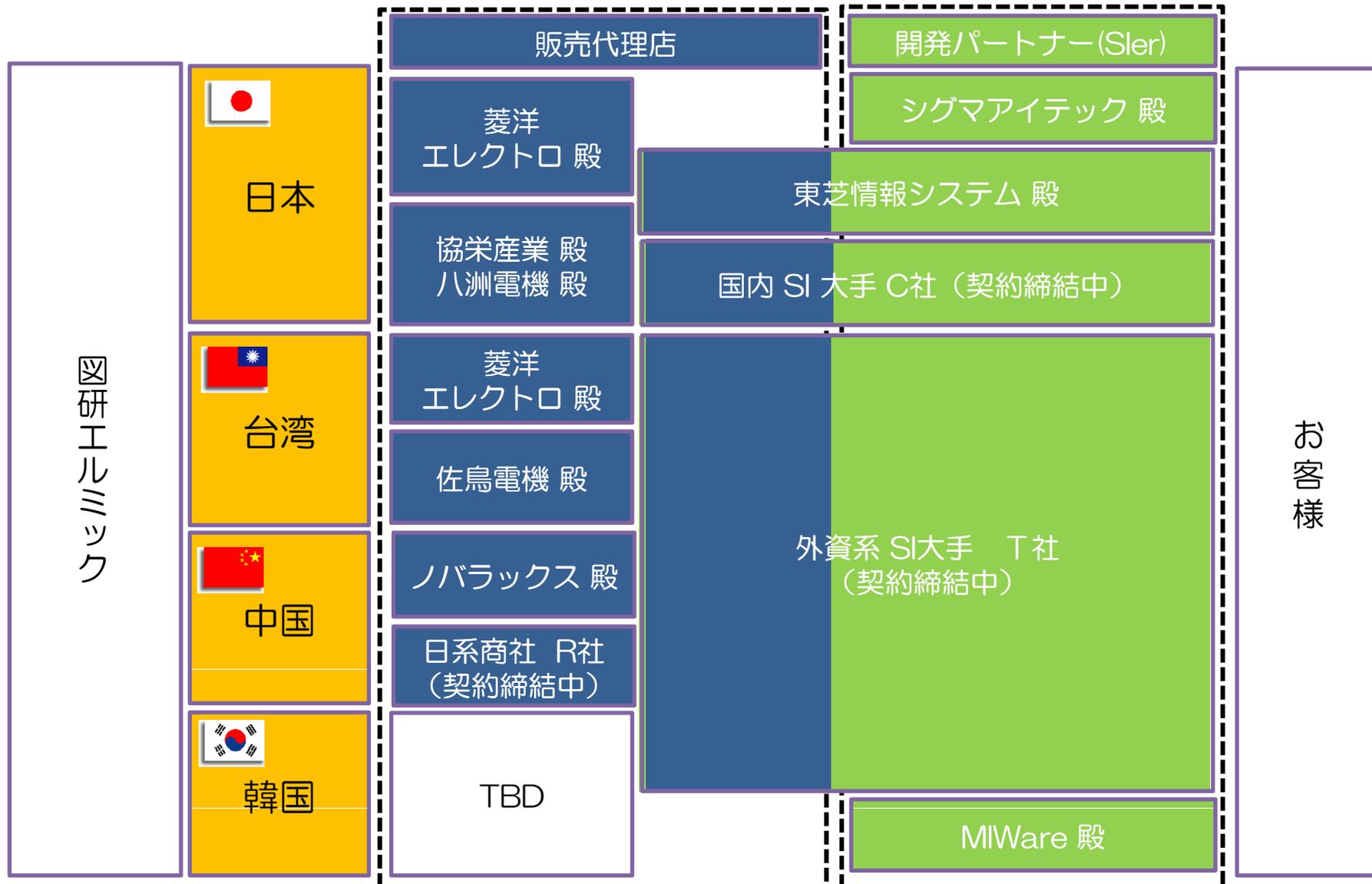


2. 車載分野

- 車載ディスプレイ機器とスマートフォンを双方向でつなぐ通信規格であるMirror Link準拠のライブラリ(Ze-PRO Mirror)の拡販。
- Mirror Link規格の最新バージョンへの対応による顧客層の拡大。
- パートナーと連携し、海外顧客へ展開。



ミドルウェア製品事業 パートナー戦略

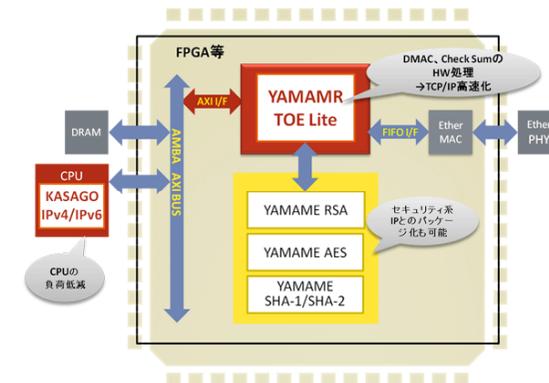


ハードウェア製品事業

ミドルウェアと連携したLSI用IPおよびモジュール製品に注力し、事業を展開。

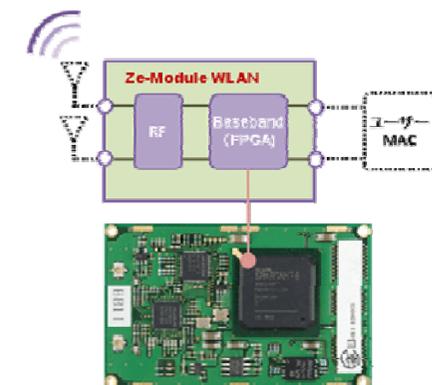
1. ネットワーク分野

- KASAGO(TCP/IP)の処理の一部をHW化した YAMAME TOE Liteと暗号化機能IPの拡販。
- HW化によるパフォーマンス向上により、高速・大容量データを扱う機器への適用など新たな顧客層を開拓。
- FPGAベンダーとの協調によるビジネスの拡大。



2. 無線通信分野

- Ze-Module WLANの拡販に注力し、量産供給を含めた顧客の拡大。
- 販売店と協力し、秘匿性やリアルタイム性を強く求められる大規模照明システム・鉄道・医療などの新しい顧客層の獲得を推進。



FA製品事業

販売手法を抜本的に見直し、既存製品のビジネス立上げを加速。

1. PC-98互換システム

- 産業分野の顧客との関係の強い商社などを販売店とし、的確な営業アプローチによる顧客獲得を推進。
- 新製品iNHERITOR II Aを投入し、手離れの良いビジネスモデルへ変更。



iNHERITOR II



iNHERITOR II A

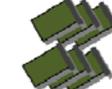
●リプレイス前



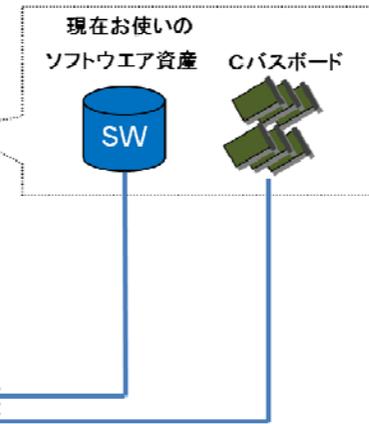
PC98



現在お使いの
ソフトウェア資産 Cバスボード



●リプレイス後



- ご注意 -

本プレゼンテーション資料および図研エルミック代表者が口頭にて提供する情報には、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれています。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているもの又は暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されています。

会社紹介

(参考資料)

会社概要

社名	図研エルミック株式会社		
設立	1977年4月30日		
資本金	1,202,036,093円 (2012年3月31日現在)		
従業員数	84名 (2012年3月31日現在)		
事業所	本社 (横浜市港北区新横浜3-1-1図研新横浜ビル2階) 大阪営業所 (大阪市浪速区湊町1-4-38近鉄新難波ビル9階)		
役員	代表取締役会長	勝部	迅也
	代表取締役社長	朝倉	尉
	取締役	下条	雅人
	取締役	小堀	秀男
	監査役(常勤)	大門	肇
	監査役	安藤	貴三男
	監査役	新井	浩之
関係会社	株式会社 図研		

沿革



- 1977年 マイコン関連の総合システムハウスとして、(株)エルミックシステムを横浜市に設立
- 1983年 ELXシリーズ(ELX-86M)販売開始
- 1984年 大阪営業所開設
- 1991年 ISDNボード(PC-INS)販売開始
- 1995年 半導体製造装置向け通信ソフトウェア(GEM)販売開始
- 1998年 組込み専用インターネットプロトコル(KASAGO TCP/IP)販売開始
- 2000年 ITRON仕様準拠RTOS(ELX-ITRON)販売開始
東証マザーズに上場(7月25日)
- 2002年 KASAGO IPv6販売開始
- 2003年 KASAGO IPv6が組込み用プロトコルとして国内初の『IPv6 Ready Logo』取得
- 2004年 半導体製造装置向け通信ソフトウェア(SoftCOMGEM300)販売開始
- 2005年 ウェスコム社と合併し、エルミック・ウェスコム株式会社に
- 2006年 TCP/IPオプションソフトウェア(IPSec)販売開始
- 2007年 株式会社シーイーシーと業務提携発表
組込み向けマルチメディア通信プロトコル(SIP)販売開始
- 2008年 株式会社図研と業務資本提携発表
- 2009年 株式会社図研よりSoC事業部を会社分割により承継(6月)
図研エルミック株式会社へ社名変更(7月)
次世代ネットワーク向け高付加価値ミドルウェアZe-PROシリーズ(RTP, ONVIF)販売開始
開発プラットフォーム製品群Z-SYSシリーズ販売開始
- 2010年 PC98アーキテクチャ互換システム(iNHERITOR II)販売開始
シリアル-LANコンバーター(MPC)販売開始
- 2011年 マルチスタイルライブラリ YAMAMEシリーズ(JPEG XR)販売開始
ONVIF NVS部ライブラリ(Ze-PRO IPrec)販売開始
- 2012年 Ze-PRO IPrecが日刊工業新聞『十大新製品賞 中堅・中小企業賞』を受賞
スマートフォン・車載機器通信規格 Mirror Link対応 ミドルウェア (Ze-PRO Mirror)販売開始

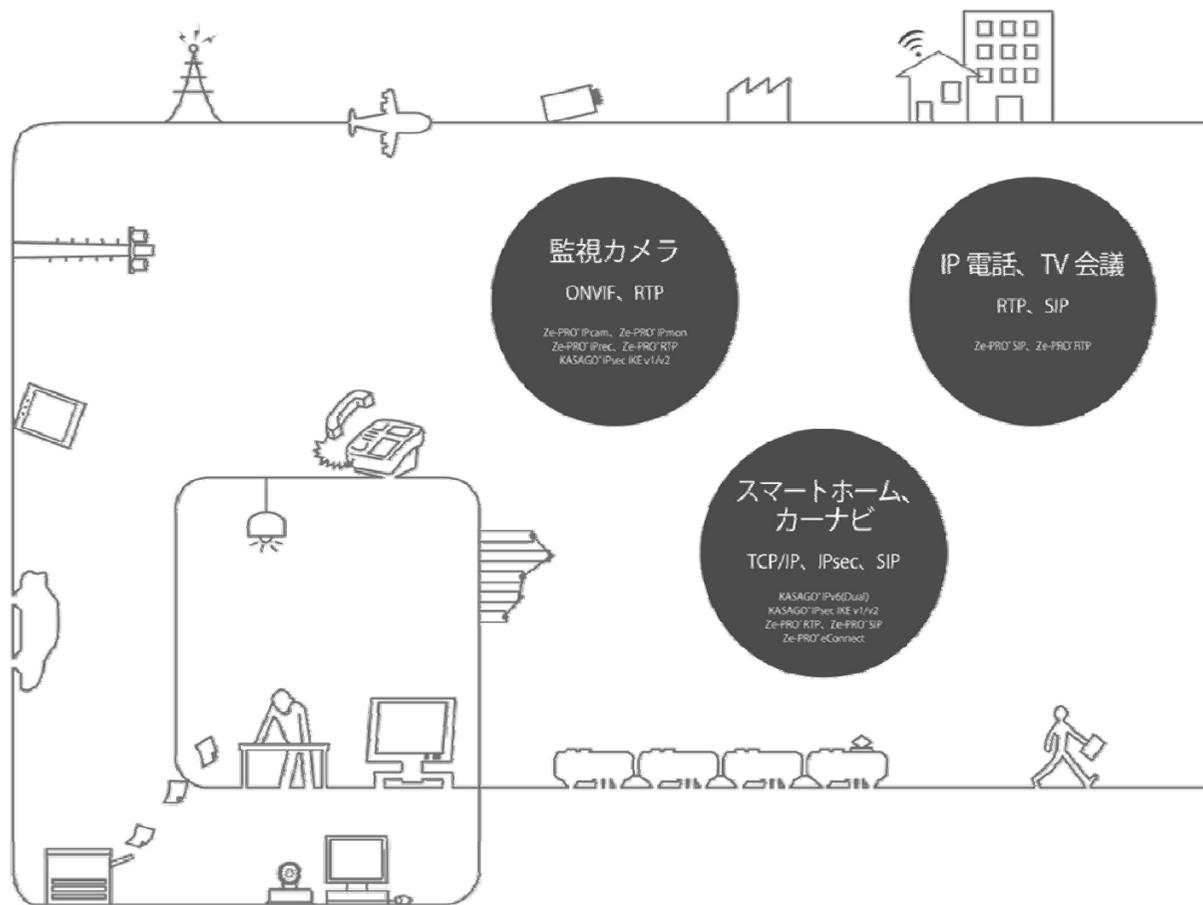
事業概要

組込システム技術を2つのアプローチでご提供



組込SW開発 / LSI・基板開発 / C Based LSI Design

つなぐ 先端ネットワーク技術を「素材」に変えて提供します。



図研エルミック株式会社

Tel : 0120-045-690

URL : <http://www.elwsc.co.jp/>

Email : info@elwsc.co.jp